

News Release

2025年6月23日

九州・沖縄地銀連携協定（Q-BASS）×京セラ株式会社の 『半導体製造装置部品切削加工ソリューションセミナー』 共同開催について

株式会社十八親和銀行（取締役頭取 山川 信彦）が参加する、九州・沖縄地銀連携協定（以下「Q-BASS」）は、京セラ株式会社との共催により、『半導体製造装置部品切削加工ソリューションセミナー』を6月20日（金）に福岡銀行本店営業部にて開催しました。

本イベントには、半導体製造装置部品の加工を担う企業をはじめ、43社/91名（オンライン参加者を含む）が参加しました。

イベントの第1部では、切削加工の活用事例と、京セラ株式会社の最新加工ソリューションや最新サービスの紹介、第2部では、ネットワーキング・加工技術相談会を開催し、参加企業間の情報交換や交流を深める場を提供しました。

十八親和銀行は、今後もQ-BASSの活動を通じて「新生シリコンアイランド九州」の実現を目指し、協定参加13行が相互に協力することで、九州・沖縄・山口経済の更なる成長に貢献してまいります。

イベント風景



〈開講挨拶〉



〈第1部セミナー〉



〈第2部ネットワーキング・加工技術相談会〉



〈第2部ネットワーキング・加工技術相談会〉

以上

《 本件に関するお問合せ先 》
（株）十八親和銀行 営業推進部
TEL 095 - 827 - 8566